

LINTEC

WAVE

株主通信誌

DECEMBER 2024

96

特集【半導体レポート】

リンテックの成長をけん引する
半導体関連製品

第131期(2025年3月期)

中間期決算情報

証券コード：7966

LINTEC WAVE 96

DECEMBER 2024



アンテロープ・キャニオン

米国・アリゾナ州バイジ近郊にある溪谷。水と風が長い年月を掛けて砂岩を削ることで、つくられた。岩壁の隙間から差し込む神秘的な太陽光が特徴。

目次

2 連結業績推移

3 株主・投資家の皆様へ

代表取締役社長
社長執行役員 **服部 真**

4 特集【半導体レポート】 リンテックの成長をけん引する 半導体関連製品

6 トピックス

7 アンケート結果のご報告

8 LINTEC ESSAY

絵本で、くつつく **岸田 雪子**

10 決算情報

12 セグメント情報

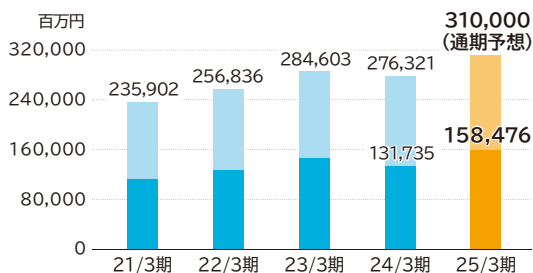
15 株式情報

(免責事項)

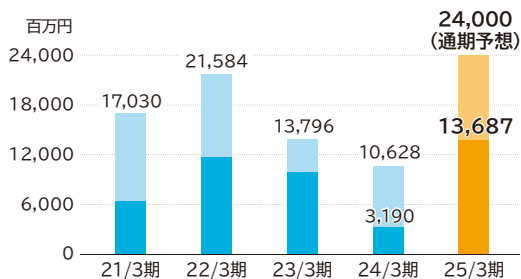
業績予想などの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績などはさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。

連結業績推移

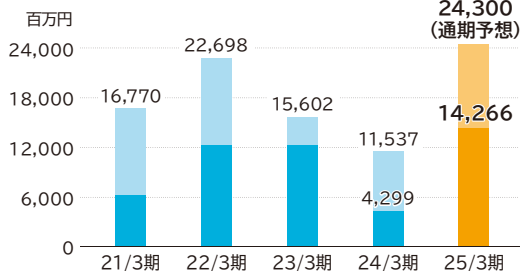
売上高



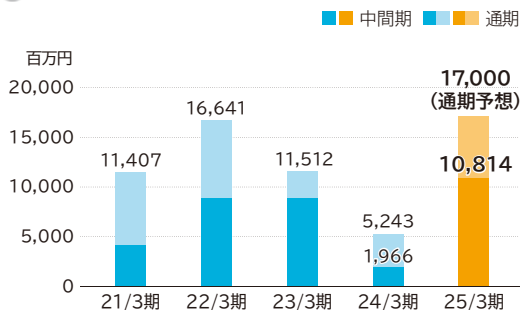
営業利益



経常利益



親会社株主に帰属する中間(当期)純利益





代表取締役社長
社長執行役員
はっとり まこと
服部 真

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。当社グループの2025年3月期中間連結会計期間の業績につきましては、売上高は半導体・電子部品関連製品が好調な需要に支えられ大幅に回復したことに加え、米国でシール・ラベル用粘着製品の販売数量が増加したことなどもあり総じて好調に推移しました。また利益面では、原燃料価格の高止まりがあったものの、上記以外の製品も販売数量が増加した効果などにより、大幅な増益となりました。

第3四半期以降も、半導体・電子部品関連製品などの受注が当初想定を上回る

▶2025年3月期中間連結会計期間(前年同期比)

売上高

158,476百万円 (20.3%増)

営業利益

13,687百万円 (329.1%増)

経常利益

14,266百万円 (231.8%増)

親会社株主に帰属する中間純利益

10,814百万円 (449.9%増)

水準で続くことを見込んでおり、2025年3月期の通期連結業績予想を下記のとおり修正しました。なお、当中間期の連結業績および通期連結業績予想の修正を踏まえ、中間配当金を当初予定の1株当たり44円から6円増額の50円に、年間配当金予想も88円から12円増額の100円に修正するとともに、11月29日に自己株式420万株の消却も行いました。今後も経営上の最重要課題の一つに位置づける株主の皆様への利益還元を充実してまいります。株主・投資家の皆様には引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

	2025年3月期通期連結業績予想		2024年3月期
	当初予想	修正予想(増減率)	実績
売上高	2,900億円 ▶	3,100億円 (6.9%増)	2,763億21百万円
営業利益	180億円 ▶	240億円 (33.3%増)	106億28百万円
経常利益	180億円 ▶	243億円 (35.0%増)	115億37百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	130億円 ▶	170億円 (30.8%増)	52億43百万円

リンテックの成長をけん引する 半導体関連製品

半導体チップの製造工程で使用される各種粘着テープやそれらを貼付・剥離するための装置が、リンテックの業績をけん引しています。今号では、当社の成長の原動力である半導体関連製品やさらなる成長へ向けた施策などをご紹介します。

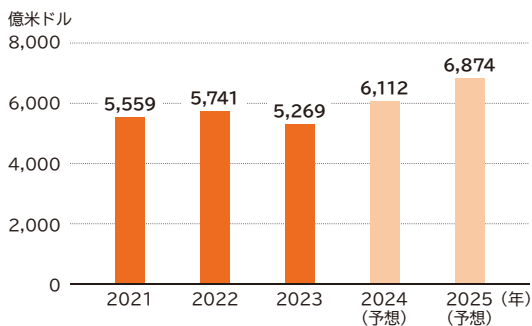
拡大する半導体需要を確実に取り込む

当社は11月に2025年3月期通期連結業績予想を上方修正しました。その最大の理由として、半導体関連粘着テープ・装置の販売数量が想定以上に推移したことが挙げられます。2022年秋口から始まった半導体市場での在庫調整が前期の途中から解消し始め、半導体関連粘着テープの当中間期の売上高は前年同期比37.8%増の195億円となりました。市況の回復に伴い、出荷数量は確実に増加しています。

こうした半導体市場の回復の背景には、生成AI(人工知能)の急速な需要拡大が関係していると見られています。日常生活からビジネスシーンまで幅広い用途で生成AIが普及し始め、データセンターのほか、パソコンやスマートフォン向けにも需要が高まり、2025年の世界の半導体市場も拡大することが予想されています。この生成

AIに必要な半導体が、半導体メモリーの一つであるDRAMを積層してつくるHBM(広帯域メモリー)です。当社はDRAMを積層する工程で使用されるテープを貼付する装置を手がけており、半導体メーカーで採用されています。このHBM向け装置を加えた当社の半導体関連装置ビジネスも、各種半導体関連粘着テープとともに当社の収益に貢献しています。

世界の半導体市場予測



出所: WSTS(世界半導体市場統計) 2024年春季予測

半導体関連市場の拡大を見据えて積極果敢に施策を展開

■先端半導体後工程の開発体制を強化

半導体製造工程は「前工程」と「後工程」に二分されますが、チップの微細化が物理的な限界に近づく中、複数のチップを積み重ねる三次元実装など後工程に関わる技術革新が、半導体の性能向上の鍵を握ると考えられています。当社は先端半導体製造の後工程に関わる新製品や独自プロセスの開発強化を目的として、2023年9月に福岡県産業・科学技術振興財団が運営する三次元半導体研究センターに入居し、同センター内に研究開発を担う新組織として「実装技術開発室」を開設しました。また、同センターの設備増強を支援するため、「企業版ふるさと納税制度」を活用し、福岡県に1億円の寄付を実施。“シリコンアイランド”として存在感を高める九州地区の半導体産業の発展にも貢献していきます。



当社が入居している三次元半導体研究センター



福岡県からの感謝状贈呈式の様子(写真左から服部誠太郎県知事、当社社長の服部真)

■EUV露光機用ペリクルを起点に新規領域を開拓

既存製品の競争力強化に加えて、新規領域の開拓にも注力しています。当社は先端半導体の微細回路形成に欠かせないEUV露光機用ペリクル(防塵材料)の第一次量産体制の構築を図るべく、国立研究開発法人産業技術総合研究所と共同研究を実施してきました。ペリクルは当社が得意とする半導体製造の後工程で使われる粘着テープとは異なり、前工程で使われる部材です。2024年7月には当社グループが独自開発したCNT(カーボンナノチューブ)製ペリクルの量産機の立ち上げに成功。早期の社会実装に向けた取り組みを加速していきます。



CNT製ペリクル膜